



2025年1月14日

各 位

会 社 名 株式会社TMH
代表者名 代表取締役社長 榎並 大輔
(コード：280A 東証グ^ラース 福証 Q-Board)
問合せ先 取締役経営管理部長 関 真希
(TEL. 097-576-7666)

2025年11月期の通期業績予想に関する策定根拠および補足説明

本日、「2024年11月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)」にて公表いたしました「2025年11月期の通期業績予想(2024年12月1日～2025年11月30日)」に関しまして、下記のとおり算定根拠等のご説明をいたします。

1. 2025年11月期の通期業績予想(2024年12月1日～2025年11月30日)

【個別】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	7,871 ～8,366	30.8 ～39.0	296 ～366	△8.4 ～13.2	286 ～356	△6.4 ～16.5	192 ～240	△29.4 ～△11.6	52.42 ～65.57

(注) 1. 当社は年次での業務管理を行っておりますので、第2四半期(累計)の業績予想の記載を省略しております。また、当社が販売する半導体製造装置の販売金額は1案件あたりの金額が大きいものもあり、2025年11月期に売上を計上すると予想していた案件が翌期での売上となった場合、業績に与える影響が現時点では大きいため、レンジ形式により開示しております。

2. 「1株当たり当期純利益」について、2024年12月に公募により発行した株式数(190,000株)およびオーバーアロットメントによる売出しに関する第三者割当増資により2025年1月に発行した株式数(73,100株)等を期中平均株式数に含めております。

2. 通期業績予想の策定根拠および補足説明

当社は、半導体工場へのトータルソリューションサービスとして「越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス」および「エンジニアリング力を活用した装置販売サービス」を中心に事業運営を進めております。特に装置販売サービスについては、引き続き市場が拡大しており、より高度な技術力を求める顧客ニーズに対応するため、積極的な提案および技術支援を行っております。さらに、サービスラインアップの充実を図ることで、幅広い半導体業界における顧客の課題解決を支援し、成長の加速を目指します。

2025年11月期の通期業績予想（2024年12月1日～2025年11月30日）につきましては、当社が販売する半導体製造装置の販売金額は1件あたりの販売金額が大きく、2025年11月期に売上を計上すると予想していた案件が翌期での売上となった場合の業績に与える影響を慎重に考慮しています。このため、投資家の皆様に対してより分かりやすく有用な情報を提供する目的で、レンジ形式で開示しております。

2025年11月期の通期業績予想につきましては、売上高は7,871百万円（前期比30.8%増）～8,366百万円（前期比39.0%増）、営業利益については296百万円（前期比8.4%減）～366百万円（前期比13.2%増）、経常利益については286百万円（前期比6.4%減）～356百万円（前期比16.5%増）、当期純利益については192百万円（前期比29.4%減）～240百万円（前期比11.6%減）であります。

なお、当社は、半導体製造フィールドソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

（1）売上高

当社の売り上げ構造は主に以下の2つのパターンに分類されます。

（越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービス）

越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービスの売上高は、「LAYLA-EC」等を通じて安定的な調達経路を確立し、また、国内外の幅広いサプライヤーとの連携をすることで部品および修理サービスを提供することによる売上から成り立っております。

以上の結果、2025年11月期の越境ECプラットフォーム等を利用した部品販売・修理サービスの売上高は、1,535百万円（前期比70.1%増）を見込んでおります。

（エンジニアリング力を活用した装置販売サービス）

エンジニアリング力を活用した装置販売サービスの売上高は、当社のエンジニア・営業人員が国内外のエンジニアリング会社やサプライヤーと協業することで、前工程を中心とした半導体製造装置に関して様々なソリューション（半導体製造装置の解体・販売・据え付けなど）を提供することによる売上から成り立っております。

以上の結果、エンジニアリング力を活用した装置販売サービスの売上高は、6,328百万円（前期比23.9%増）～6,823百万円（前期比33.5%増）を見込んでおります。

以上を踏まえ、当社全体の2025年11月期売上高は、7,871百万円（前期比30.8%増）～8,366百万円（前期比39.0%増）を計画しております。

（2）営業利益

売上原価は、販売する半導体製造装置および部品の仕入れおよび修理コストならびに顧客への役務提供に直接関与する労務費および配送費等から構成されております。

2025年11月期の販売費及び管理費は、主に人件費・採用教育費・旅費交通費・管理諸費で構成されております。

そのうち人件費および採用教育費（425百万円）（前期比24.2%増）は販売費及び一般管理費の全体の66.0%を占めております。当社においては、持続的な成長のために半導体製造装置に関連する知見や技術ノウハウを持つ人材、あるいは数か国語を話せるバイリンガル人材を確保することが重要な経営課題であると認識しております。そのため、人件費および採用教育費に重点的に予算を配分するこ

とにより当社の事業成長に繋がると考えております。

旅費交通費（38百万円）は営業活動のための国内外への出張旅費であります。当社は販売先および仕入先を問わず外国企業との取引も多いことから前年実績等を基に見積もっております。

管理諸費（29百万円）は主に監査報酬であります。

以上から、2025年11月期における営業利益は296百万円（前期比8.4%減）～366百万円（前期比13.2%増）を計画しております。

（3）経常利益

営業外収支（△9百万円）は主に上場関連費用であります。

以上から、2025年11月期の経常利益については286百万円（前期比6.4%減）～356百万円（前期比16.5%増）を計画しております。

（4）当期純利益

特別利益および特別損失につきましては計画をしておりません。

法人税等は、実効税率を用いて算定をしております。

以上から、2025年11月期の当期純利益は192百万円（前期比29.4%減）～240百万円（前期比11.6%減）を計画しております。

なお、当期純利益につきまして、上限値を含めて前期（2024年11月期）と比較しての減益要因は、本日公表いたしました「繰延税金資産の計上に関するお知らせ」のとおり、2024年11月期において繰延税金資産を26百万円計上したことにより2024年11月期の税金負担が減少したことによるものです。

【業績予測に関するご留意事項】

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断および仮定を前提としており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。

以 上